



Geely Auto gears up NEV transformation with STMicroelectronics

吉利汽車與意法半導體簽署碳化矽長期供應協定，深化新能源汽車轉型並成立創新聯合實驗室，推動雙方創新合作

- 意法半導體第三代SiC MOSFET協助吉利汽車集團純電車型提升電驅效能
- 雙方成立創新聯合實驗室，共同推動節能智慧化電動汽車發展

【臺北訊，2024年6月5日】—服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導廠商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）與全球汽車及新能源汽車領導車商吉利汽車集團（香港交易所代碼：HK0175）宣布，雙方簽署碳化矽（SiC）元件長期供應協議，加速碳化矽元件的合作。按照協議規定，意法半導體將為吉利汽車旗下數個品牌之中高階純電動汽車提供SiC功率元件，協助吉利提升電動車性能、加快充電速度、延長續航里程，以及深化新能源汽車轉型。此外，吉利和ST將在多個汽車應用領域的長期合作基礎上，打造創新聯合實驗室，交流與探索在車用電子／電氣（E/E）架構（如車載資訊娛樂、智慧座艙系統）、進階駕駛輔助（ADAS）和新能源汽車等相關領域的創新解決方案。

吉利汽車集團電驅逆變器已採用意法半導體先進的第三代SiC MOSFET元件。電驅逆變器是電驅系統的核心，而碳化矽MOSFET則可全面提升電驅逆變器的效能。將先進的逆變器設計與SiC等高效功率半導體結合，是獲取電動汽車卓越性能的關鍵。

吉利汽車中央研究院院長李傳海表示，「非常高興能夠與意法半導體展開雙贏合作，相互授權並充分利用

各自的優勢和資源。相信透過創新聯合實驗室的合作，我們可以加深彼此合作、互利共贏，並加速創新技術在吉利汽車的開發和落地。」

吉利汽車中央研究院電子電器中心主任付朝輝進一步表示，「很高興能與全球車用半導體領導者意法半導體展開深度合作並成立創新聯合實驗室。雙方將深化在智慧汽車相關的長期合作，共同聚焦客戶需求，加速新產品新方案落地，建立高效直接的合作體系。相信透過此次合作將有利於雙方結合智慧化、電動化、連網化的發展趨勢，展開更具前瞻性的技術研究。吉利非常高興能依託意法半導體領先的汽車業務解決方案，在產品性能、系統整合和市場競爭力等層面取得優勢。」

意法半導體執行副總裁暨中國區總裁曹志平則補充說道，「吉利汽車是中國汽車產業創新的傑出代表，正在快速推動電動化、智慧化和全球化佈局。意法半導體與吉利汽車達成SiC元件長期供應協議並成立聯合實驗室，代表著雙方長期合作的關係邁出了重要一步。中國擁有全球最大的新能源汽車市場和領先的創新市場。ST致力於透過在本地設立的技術創新中心，以及與汽車產業鏈上的客戶和合作夥伴建立聯合實驗室，以支援中國的汽車創新和轉型升級。」

作為則為全球領先的汽車製造商和中國和第一汽車品牌，2023年吉利汽車全年總銷售量達168萬輛，其中新能源汽車銷量為48萬輛，佔吉利汽車全年總銷量的28%，較去年增加48%，新能源轉型卓有成效，產業影響力顯著提升。

意法半導體具備先進的SiC生產技術和完全垂直整合的供應鏈。在汽車領域，意法半導體SiC產品廣泛應用於牽引逆變器、車載充電器機（OBC）、直流-直流轉換器（DC-DC）、充電樁及電動壓縮機應用，可以極大提升新能源汽車的性能、效能和續航里程。2023年6月，意法半導體宣佈與中國化合物半導體龍頭企業三安光電達成合資協議，在重慶新建一個8英寸SiC元件合資製造廠，以滿足中國客戶需求。同時，意法半導體正在與更多中國知名汽車製造商、工業客戶和解決方案供應商在SiC領域展開合作，攜手加速中國電氣化產業進程。

關於吉利控股集團

吉利控股集團始創於1986年，1997年進入汽車產業，一直專注實業，專注技術創新和人才培養，不斷打基礎練內功，堅定不移地推動企業轉型升級和永續發展。現資產總值超5,100億元，員工總數超過14萬人，連續十二年進入《財富》世界500強（2023年排名225位），是全球汽車品牌組合價值排名前十中唯一的中國汽車集團。

吉利控股集團致力於成為具有全球競爭力和影響力的智慧電動出行和能源服務科技公司，業務涵蓋汽車及上下游產業鏈、智慧出行服務、綠色運力、數位科技等。集團以汽車產業電動化和智慧化轉型為核心，在新能源科技、共用出行、車聯網、智慧駕駛、車載晶片等前沿技術領域，打造科技護城河，做強科技生態圈。詳情請流覽吉利控股集團官網：www.geely.com

關於意法半導體

意法半導體匯聚超過 5 萬名半導體技術的創造者和製造者，掌握半導體供應鏈和先進的製造設備。做為一家整合元件製造商（IDM），意法半導體與逾 20 萬家客戶與數千個合作夥伴一起研發產品和解決方案，攜手建立生態系統，協助客戶因應挑戰和新機會，滿足世界對於永續發展之更高的需求。意法半導體的技術讓人們出行更智慧，電源和能源管理更高效，物聯網和連接技術的使用更廣泛。意法半導體致力於 2027

年達成碳中和（適用於範圍 1 和範圍 2，以及部分範圍 3）之目標。更多資訊，請瀏覽意法半導體官方網站：www.st.com。